证券代码: 300656 证券简称: 民德电子 公告编号: 2024-097

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称"浦发银行深圳分行"或"贷款人")申请额度 6,300 万元的并购贷借款,用于收购广芯微电子 15.6738%股权,具体详见公司同日于巨潮资讯网上公布的《关于向银行申请借款及质押资产的公告》(公告编号:2024-096)。对于该笔借款,公司全资子公司广东省民德半导体有限公司(以下简称"民德半导体")提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,民德半导体已履行了内部审批程序,上述担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

被担保人:深圳市民德电子科技股份有限公司

成立日期: 2004年2月23日

注册地点:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层(1)号

法定代表人: 许文焕

注册资本: 17,112.5072 万人民币

经营范围: 兴办实业(具体项目另行申报); 计算机软、硬件的技术开发、设计; 电子通讯产品的开发、系统集成; 嵌入式芯片、软件的开发、系统集成(以上均不含加工组装及限制项目); 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品); 条码扫描识别及打印设备的技术开发、技术服务; 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营); 电子产品销售;

以自有资金从事投资活动。住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)条码扫描识别及打印设备的生产(凭有效的环保批复经营)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、被担保人主要财务指标

	2024年1-9月	2023 年度
	(未经审计)	(经审计)
营业收入 (元)	259, 836, 628. 05	399, 509, 326. 59
利润总额 (元)	-11, 185, 277. 30	18, 325, 935. 90
净利润 (元)	-12, 050, 673. 81	14, 634, 159. 97
	2024年9月30日	2023年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
资产总额 (元)	1, 666, 824, 998. 87	1, 762, 251, 656. 83
负债总额 (元)	535, 483, 395. 01	581, 247, 254. 48
资产负债率	32. 13%	32. 98%

3、信用情况:经查询,公司不属于失信被执行人,信用状况良好。

三、担保协议主要内容

- 1、保证人:广东省民德半导体有限公司
- 2、债务人:深圳市民德电子科技股份有限公司
- 3、债权人:上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
- 4、担保方式:连带责任保证
- 5、担保的最高债权额:人民币陆仟叁佰万元整
- 6、担保期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日,公司及合并报表范围内子公司尚未到期的对外担保总额为人民币 48,000 万元,公司以持有的广微集成 83.5135%的股权做质押向银行申请借款6,868 万元,加上此次民德半导体为公司提供的担保 6,300 万元,上述担保总金额约为人民币 61,168 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 52.48%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况, 无涉及诉讼的担保事项, 不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、民德半导体与浦发银行深圳分行签署的《最高额保证合同》;
- 2、民德半导体股东决定。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会 2024年11月13日